

Mirtec Mv-3



Автоматическая оптическая инспекция Mv-3 – это настольная система для инспекции дефектов производства как до, так и после пайки, подходящая по своим параметрам для мелкого и среднего производства. Основные определяемые дефекты: поднятый вывод, поднятый компонент, могильные камни, мосты, неправильно установленный компонент, излишнее количество припоя, недостаточное количество припоя, открытая площадка, пропущенный компонент, неточное совмещение, сдвинутый компонент, полярность, проверка цифровой и цветовой маркировки, установка другого компонента (оптическое распознавание), перевернутый компонент, царапина на площадке, шарики припоя, поднятые компоненты в корпусах QFP/BGA (при помощи лазера).

Технические характеристики:

- Разрешение камеры 5 или 10 Мпик
- Телецентрическая линза
- 6-ти уровневая подсветка
- Проверка компонентов 01005
- Лазерная проверка компланарности BGA, CSP

Перечень опций:

- Система из 4-х цветных боковых камер
- Лазерная система «Intelli-Beam»
- Механический маркировщик дефектов на плате
- Система чтения штрихкода
- Программное обеспечение для удаленного программирования
- Программное обеспечение для удаленного ремонта

Краткая спецификация автоматической оптической инспекции серии MV-3

Тип		MV-3L	MV-3U
Область инспекции ПП		50 x 50-450 x 400 мм	50 x 50-660 x 510 мм
Толщина проверяемой платы		0.5 – 3 мм	
Поле обзора / Разрешение изображения	5 Мпик	Опция 1	47,76 x 34,94 мм / 18,2 мкм / пиксель
		Опция 2	35,16 x 25,73 мм / 13,4 мкм / пиксель
		Опция 3	25,72 x 18,8 мм / 9,8 мкм / пиксель
Скорость проверки	5 Мпик	Опция 1	5 959 мм ² / с (0,28 с / кадр)
		Опция 2	3 479 мм ² / с (0,26 с / кадр)
		Опция 3	2 016 мм ² / с (0,24 с / кадр)
Поле обзора / Разрешение изображения	10 Мпик	Опция 1	66,68 x 49,79 мм / 18,2 мкм / пиксель
		Опция 2	49,09 x 36,66 мм / 13,4 мкм / пиксель
		Опция 3	35,90 x 26,81 мм / 9,8 мкм / пиксель
Скорость проверки	10 Мпик	Опция 1	8 972 мм ² / с (0,37 с / кадр)
		Опция 2	5 293 мм ² / с (0,34 с / кадр)
		Опция 3	3 007 мм ² / с (0,32 с / кадр)
Проверка самого маленького компонента		Опция 1	ИС 0603 / шаг ИС 0,4 (мм)
		Опция 2	ИС 0402 / шаг ИС 0,3 (мм)
		Опция 3	ИС 0402 / шаг ИС 0,3 (мм)
Разрешение центральной камеры		5 мегапикселей (2 456 x 2 058 пикселей) 10 мегапикселей (3 664 x 2 736 пикселей)	
4 боковые камеры «Side Viewer»®		«SideViewer»®: 5 мегапикселей (2 592 x 1 944 пикселей) / 4 шт.	
Система освещения		6-ти уровневая цветная система освещения (вертикальная, горизонтальная, коаксиальная); система освещения по четырем углам; настройки заданные пользователем.	
Лазерная система		Повторяемость, точность измерения Z-высоты: ± 20 мкм Разрешение: 15 мкм / точка	
Типы выявляемых дефектов		поднятый вывод, поднятый компонент, могильные камни, мосты, неправильно установленный компонент, излишнее количество припоя, недостаточное количество припоя, открытая площадка, пропущенный компонент, неточное совмещение, сдвинутый компонент, полярность, проверка цифровой и цветовой маркировки, установка другого компонента (оптическое распознавание), перевернутый компонент, царапина на площадке, шарики припоя, поднятые компоненты в корпусах QFP / BGA (при помощи лазера).	
ПК		ЦПУ «Intel® Core™ 2 Duo», ЖК-монитор 19", ОС «MS Windows XP Professional»	
Условия эксплуатации		Температура: 10 – 40 °С, влажность 30 – 80 %	
Требования по питанию		1 фаза переменного тока, 85 – 264 В, 50 / 60 Гц	
Габаритные размеры (Д x Ш x В)		975 x 1200 x 655 мм	1185 x 1455 x 690 мм
Вес		110 кг	160 кг

ООО «ЛионТех»
mail@liontech.ru



**Бесплатные консультации
для наших заказчиков:**

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru